

## レゾナック、日本メーカー初の戦略パートナーとして 先端半導体の米コンソーシアム「TIE」に参画

～Intel、Micron、AMD、AMAT\*など米国半導体大手とともに技術の研究・開発を進める～

株式会社レゾナック（社長：高橋秀仁、以下 当社）は、米国テキサス州にある半導体コンソーシアム「Texas Institute for Electronics」（以下、TIE）に日本メーカー、また材料メーカーとしても初めて、戦略パートナーとして参画します。



TIE は、米国テキサス大学オースティン校が主導する非営利団体で、テキサス州や半導体・防衛エレクトロニクス企業、国立研究所、学術機関の官民で構成されています。半導体の最先端技術のロードマップを 5 年早め、米国で最先端の技術を生み出すことを目的としています。TIE の戦略パートナー企業は、米国の大手半導体メーカーである Intel、Micron、AMD、AMAT\*1 等です\*2。当社は、①先端構造の半導体に使用する前工程から後工程までの材料を揃えていること②半導体のパッケージに特化して研究開発を行うパッケージングソリューションセンターを所有していることやその知見③半導体関連企業で構成されたコンソーシアム「JOINT2」の運営実績の 3 点を評価され、参画要請をうけました。TIE に戦略パートナーとして参画するのは、日本メーカーでも、材料メーカーでも当社が初めてです。TIE は 2024 年後半から 2.xD、及び 3D パッケージの試作ラインを立ち上げる計画です。

半導体は社会インフラとして生活を支える大きな役割を担っています。進化する AI や次世代通信に使用される最先端の半導体を開発するためには、デバイスや材料、装置メーカーが垣根を越えて連携することが必要です。当社は TIE への参画により他社との共創を図り、最先端技術の研究・開発を進め課題解決に寄与することを目指します。

当社は「化学の力で社会を変える」というパーパスの下、共創を通じて社会課題である半導体の性能向上に努めてまいります。

■ Texas Institute for Electronics の web サイト

<https://www.txie.org/>

\*1 AMAT：米国 Applied Materials 社

\*2 2023 年 10 月末時点

以上

【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、2023 年 1 月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合してできた新会社です。

半導体・電子材料の売上高は、全体の 3 割にあたる約 4,000 億円に上り、特に半導体の「後工程」材料では世界 No.1 の企業です。2 社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistry の「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス

ブランド・コミュニケーション部 広報グループ

TEL 03-6263-8002